

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成26年7月17日(2014.7.17)

【公開番号】特開2013-161863(P2013-161863A)

【公開日】平成25年8月19日(2013.8.19)

【年通号数】公開・登録公報2013-044

【出願番号】特願2012-20829(P2012-20829)

【国際特許分類】

H 01 L 21/301 (2006.01)

H 01 L 21/304 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/78 Q

H 01 L 21/304 601Z

【手続補正書】

【提出日】平成26年5月30日(2014.5.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

外周端部に厚肉部を、中央部に薄肉部を有する半導体ウエハを準備する工程と、前記半導体ウエハの一方の面に支持部材を装着する工程と、前記支持部材の装着後に、前記半導体ウエハを前記厚肉部と前記薄肉部とに分割する工程と、

前記分割後に、前記支持部材で前記薄肉部を支持した状態で前記薄肉部を切断する工程と、を備える、半導体装置の製造方法。

【請求項2】

前記分割後に前記厚肉部を前記支持部材から分離する工程をさらに備える、請求項1に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項3】

前記支持部材は粘着テープを含み、前記粘着テープは、前記薄肉部から前記厚肉部にわたって貼付られる、請求項1または請求項2に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項4】

前記厚肉部を、前記粘着テープから分離する前に、前記厚肉部と接する部分における前記粘着テープの粘着力を低下させる工程を備える、請求項3に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項5】

前記厚肉部を前記支持部材から分離した後に、前記支持部材を伸張させる工程をさらに備える、請求項2～請求項4のいずれか1項に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項6】

前記厚肉部を直接保持して分離する、請求項2～請求項5のいずれか1項に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項7】

前記厚肉部を真空吸着することにより保持する、請求項6に記載の半導体装置の製造方

法。

【請求項 8】

前記厚肉部を静電吸着することにより保持する、請求項6に記載の半導体装置の製造方法。